ArF液浸スキャナー「NSR-S636E」を開発

株式会社ニコン　　2021年10月19日

株式会社ニコン（社長：馬立 稔和、東京都港区）は、高い重ね合わせ精度と高スループットを実現し、最先端の半導体デバイス製造に対応するArF液浸スキャナー「NSR-S636E」の開発を進めています。発売は、2023年を予定しています。

ArF液浸スキャナー「NSR-S636E」

DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速する中、より大容量のデータをいっそう高速に処理・通信するニーズが増加しています。これには高性能な半導体が必要不可欠であるため、回路パターンの微細化と半導体デバイス構造の三次元化という両輪による技術革新が進んでいます。

「NSR-S636E」は、改良した高機能アライメントステーション「inline Alignment Station（iAS)」を搭載し、多点アライメントによる計測と高次補正によって、半導体デバイス構造の三次元化に必要な高い重ね合わせ精度と高生産性の両立を目指しています。ロジック半導体やメモリー半導体、CMOSイメージセンサーなど最先端の半導体デバイス製造に対応する予定です。

ニコンは、今後も最先端の半導体デバイス製造に欠かせない露光装置を提供することによってお客様のニーズに応え、付加価値の高い半導体製造に貢献していきます。

＞半導体露光装置関連：半導体装置事業 ホームページ

こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。